



Nota de Prensa

Kioxia Europe GmbH presenta BiCS FLASH™ de quinta generación

La memoria flash 3D de nueva generación añade capas, aumenta la capacidad, un ancho de banda más amplio y proporciona una nueva flexibilidad de diseño

Düsseldorf, Alemania 3 de febrero de 2020 - Kioxia Europe GmbH, líder mundial en soluciones de memoria, ha anunciado hoy que ha desarrollado con éxito su memoria flash tridimensional (3D) BiCS FLASH™ de quinta generación con una estructura apilada verticalmente de 112 capas. Kioxia planea comenzar a enviar muestras del nuevo dispositivo, que tiene una capacidad de 512 gigabits (64 gigabytes) con tecnología de 3 bits por celda (celda de triple nivel, TLC), para aplicaciones específicas en el primer trimestre del año calendario 2020^{*1}. El nuevo dispositivo tiene como objetivo satisfacer las demandas de bits cada vez mayores para una amplia variedad de aplicaciones, incluidos dispositivos móviles tradicionales, SSD para consumidores y empresas, aplicaciones emergentes habilitadas por las nuevas redes 5G, inteligencia artificial y vehículos autónomos.

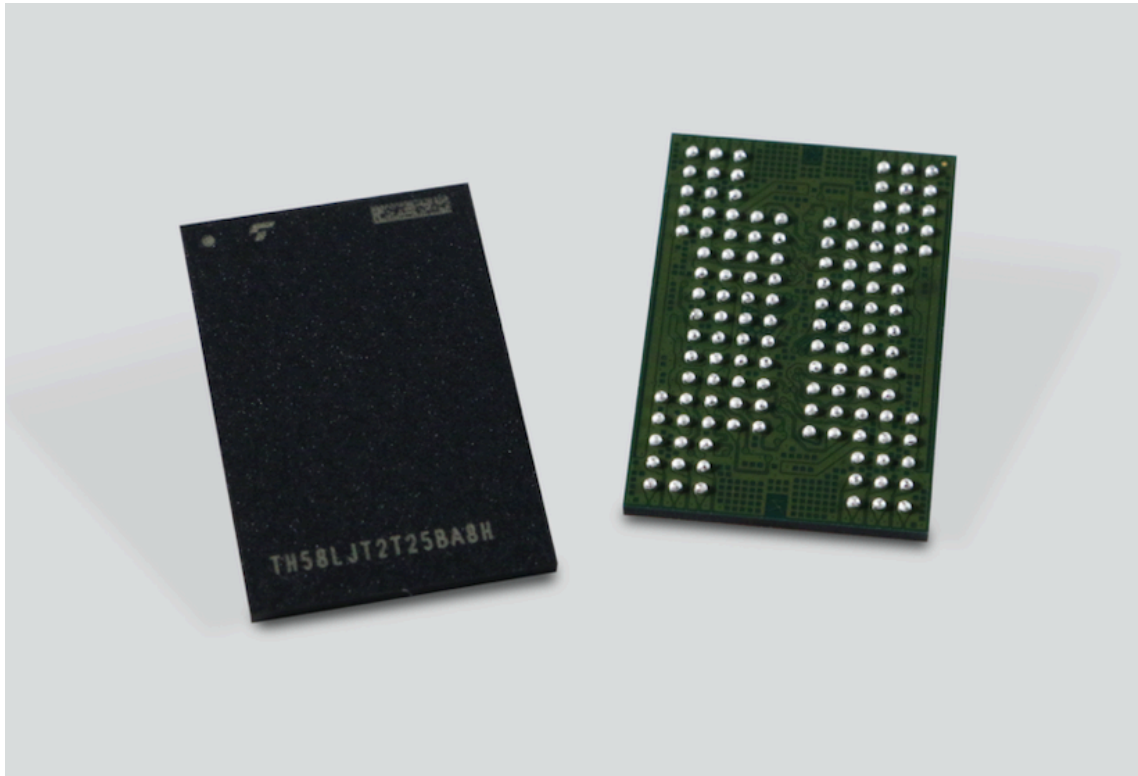
En el futuro, Kioxia aplicará su nueva tecnología de proceso de quinta generación a dispositivos de mayor capacidad, como TLC de 1 terabit (128 gigabytes) y dispositivos de 1,33 terabit de 4 bits por celda (celda de nivel cuádruple, QLC).

La innovadora tecnología de proceso de apilamiento de 112 capas de Kioxia se combina con la tecnología avanzada de circuitos y procesos de fabricación para aumentar la densidad de la matriz de células en aproximadamente un 20 por ciento sobre el proceso de apilamiento de 96 capas. La nueva tecnología reduce el coste por bit y aumenta la capacidad de fabricación de memoria por oblea de silicio. Además, mejora la velocidad de la interfaz en un 50 por ciento y ofrece un mayor rendimiento de programación y una latencia de lectura más corta.

Desde el anuncio del primer prototipo de tecnología de memoria flash 3D^{*2} del mundo en 2007, Kioxia ha seguido avanzando en el desarrollo de la memoria flash 3D y está promoviendo activamente BiCS FLASH™ para satisfacer la demanda de mayores

capacidades con tamaños de pastilla más pequeños.

La quinta generación de BiCS FLASH™ se desarrolló conjuntamente con Western Digital Corporation, socio tecnológico y de fabricación. Se fabricará en la planta de Yokkaichi de Kioxia y en la planta de Kitakami de nueva construcción.



La imagen se puede descargar aquí: <http://www.publitekrc.com/PR%5FPICTURES/Kioxia/KIE007/>

Notas:

1. No todas las características han sido probadas y las características del dispositivo pueden cambiar en el futuro.

2. Fuente: Kioxia Corporation, al 12 de junio de 2007.

* Todos los demás nombres de compañías, nombres de productos y servicios mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivas compañías.

Sobre KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (anteriormente Toshiba Memory Europe GmbH) es una empresa europea subsidiaria de [KIOXIA Corporation](#), un proveedor líder mundial de (SSD). Desde la invención de la memoria flash hasta el innovador BiCS de hoy

Con la tecnología FLASH™ 3D, KIOXIA continúa siendo pionera en soluciones de memoria de vanguardia y servicios que enriquecen la vida de las personas y expanden los horizontes de la sociedad. La tecnología innovadora de memoria flash 3D de la empresa, BiCS FLASH™, está dando forma al futuro del las aplicaciones de almacenamiento en alta densidad, incluidos teléfonos inteligentes avanzados, PC, SSD, automoción y centros de datos.

Detalles de contacto para medios:

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Germany

Tel: +49 (0)211 368 77-0 Fax: +49 (0) 211 368 774 00

E-mail: KIE-support@kioxia.com

Detalles de contacto para consulta editorial:

Sandrine Aubert, KIOXIA Europe GmbH

Tel: +49 (0) 211 36877 579

Email: sandrine.aubert@kioxia.com

Distribuido por:

Birgit Schöniger, Publitek

Tel: +44 (0)1582 390980

Email: birgit.schoeniger@publitek.com

Web: www.publitek.com

Ref. KIE007_SPA